

- 1.. 本機台 SEM 工作距離設定 8mm (請勿任意變動)
EDX 工作距離設定 15mm (請注意)
- 2.. 確認 IP3 真空，正常維持在 $2\sim 3 \times 10^{-6}$ 或更低，大於 5×10^{-5} ，暫停使用。
- 3.. 確認 DEW, 如 DEW 燈亮, SEM 機台請勿使用, 請通知技術員.
- 4.. 檢查操作記錄簿.
- 3.. 樣品製備:
 - ★請帶上乾淨的手套, 避免用裸手去接觸試樣或載台.
 - ★使用導電膠帶固定樣品時, 應依樣品用適宜長度的導電膠帶, 因導電膠帶本身會吸附氣體並於真空中釋放而影響真空, 且試片要貼牢, 可避免看高倍時試片晃動
 - ★拍攝清楚影像試片導電性一定要好, 如導電性不好, 它可以鍍Pt.
- 4.. 放置樣品於樣品支撐座上(確定樣品的高度是在標準高度計量器以下的程度)
- 5.. 檢查操作面板
- 6.. 將樣品座放入樣品室
- 7.. HV ON
- 8.. 影像調整
 - ※※相關操作流程步驟、操作面板功能解說、EDX操作流程、鍍金機在機台旁皆放置詳細圖解
- 9.. 影像存檔
- 10.. 完成操作, 移出樣品
 - ★確認Tilt 歸0 工作距離(WD): 8.0mm Rotation: 0
 - ★若有變更參數請改回原設定.
 - ★按 HOME 鍵
 - ★HV off
 - ★將樣品座至樣品室取出.
- 11.. 刷卡退出
- 12.. 確實填寫記錄表，**檢查Pt sputter 是否關閉** 再離開.